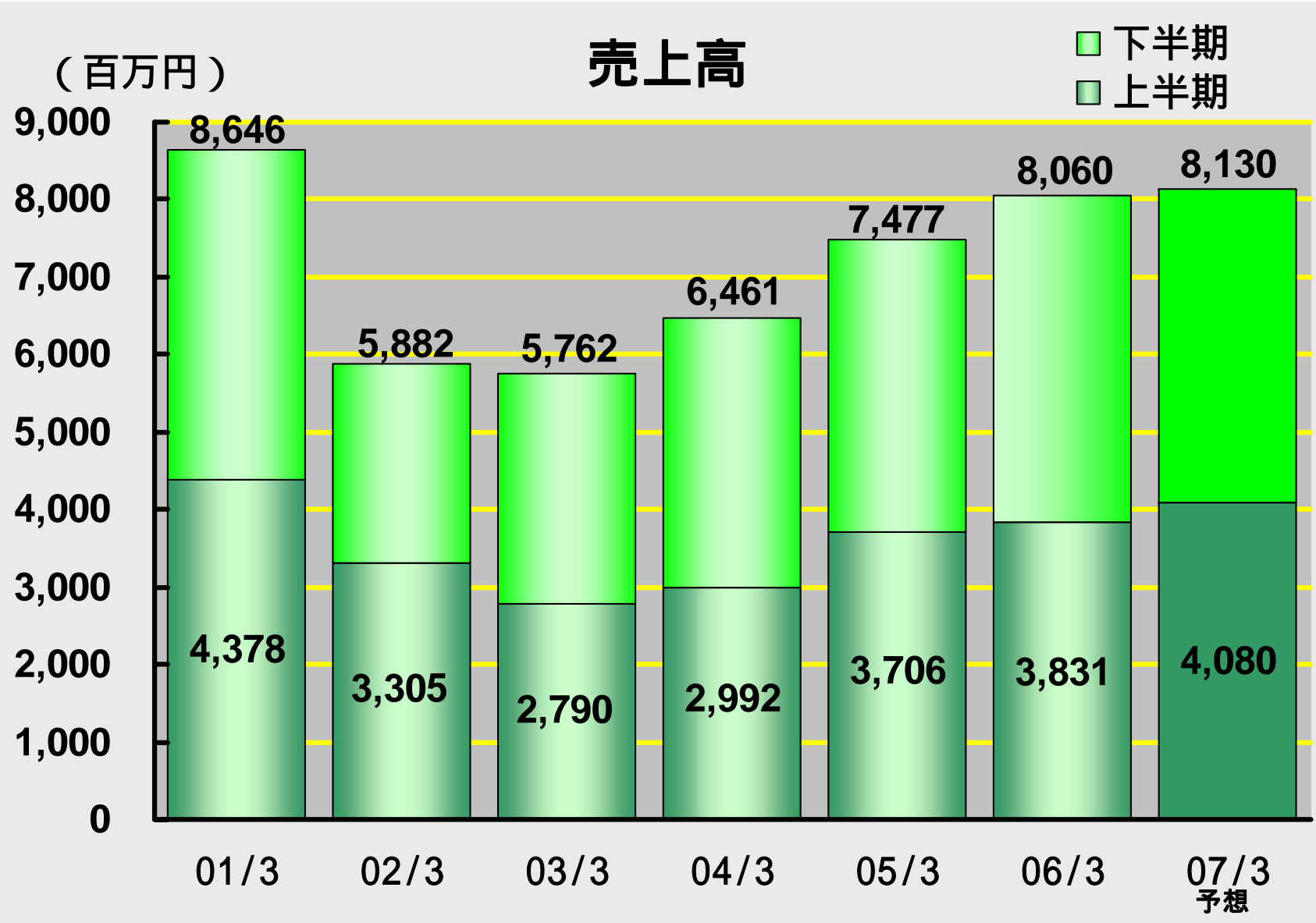
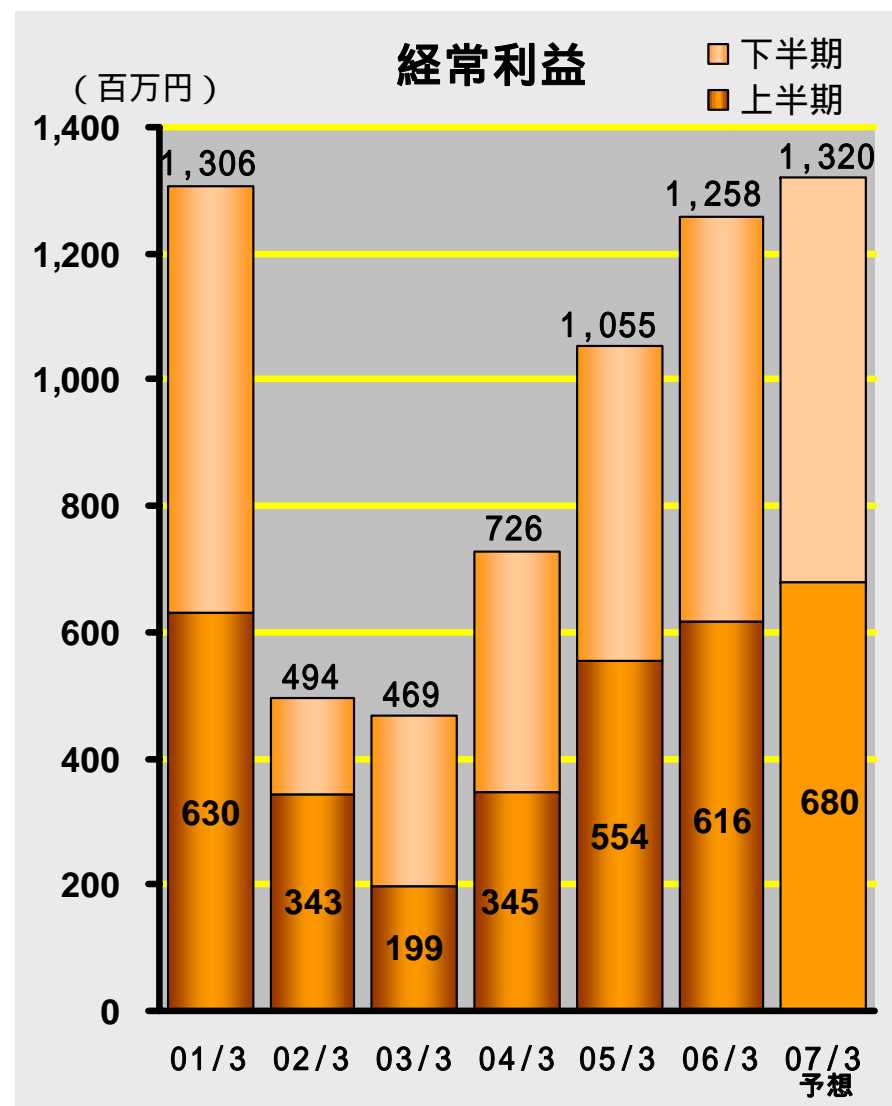
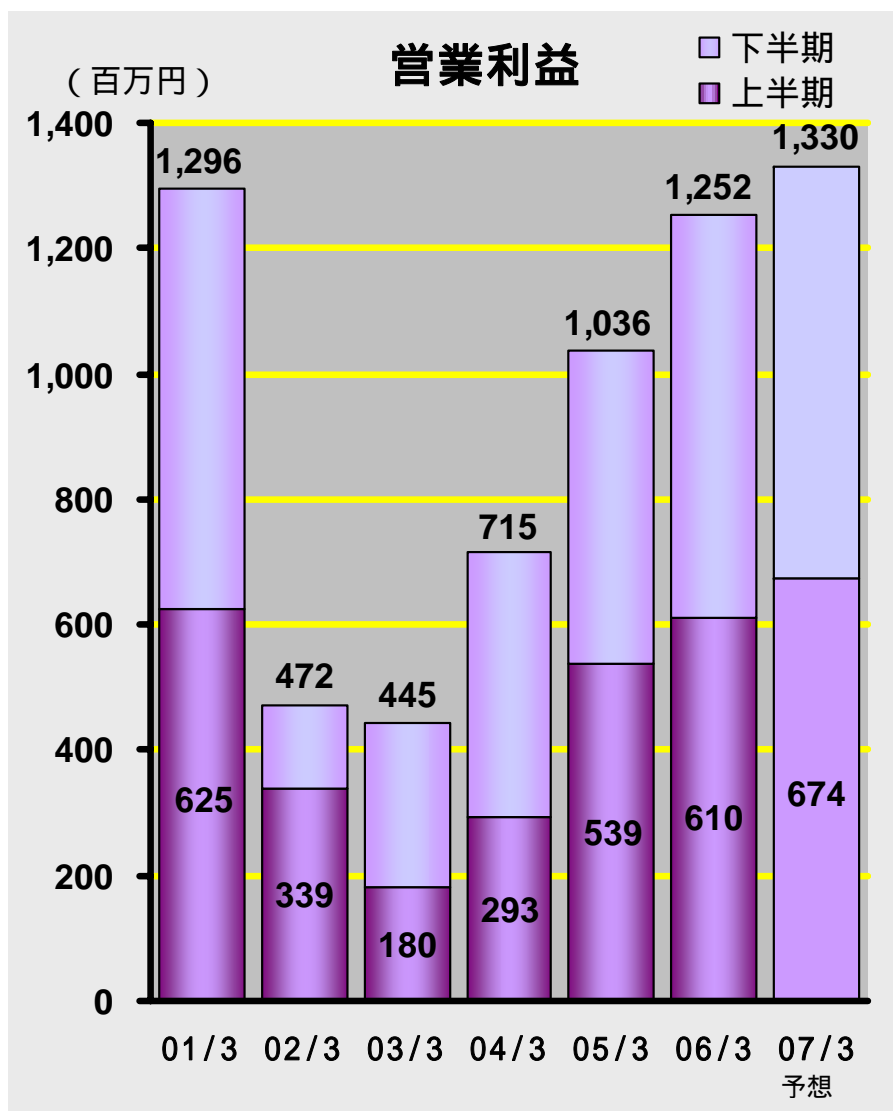


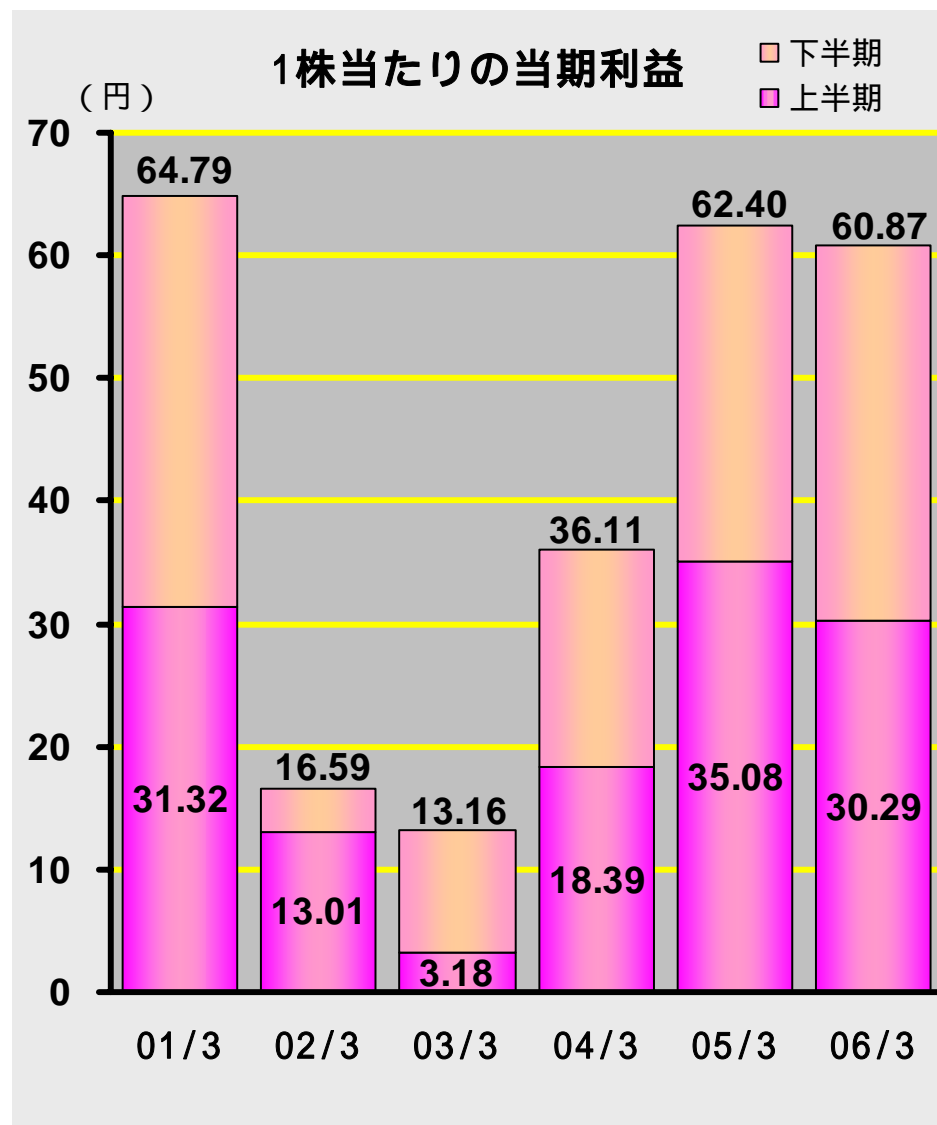
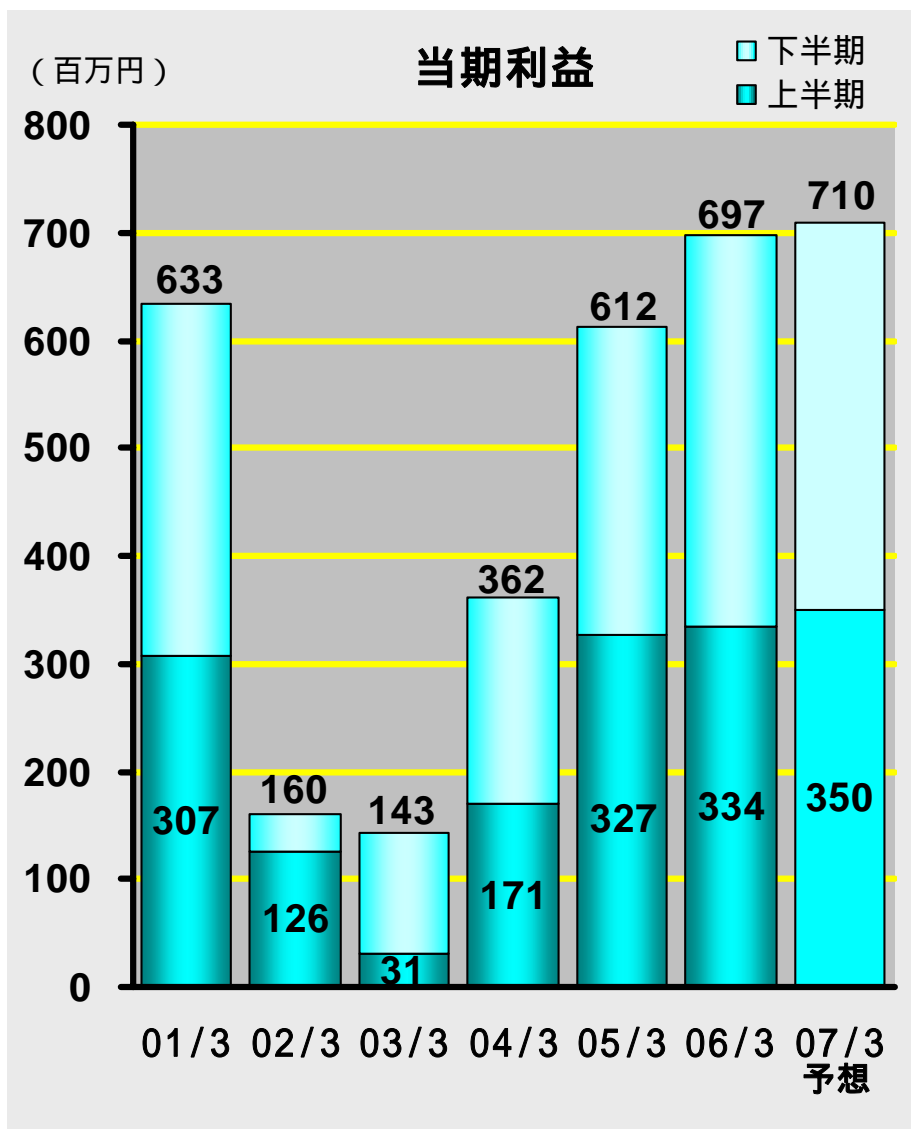
業績のハイライト

	2006年 3月期			2005年 3月期		
		前期比	売上高構成比		前期比	売上高構成比
売上高	8,060,087	7.8 %		7,476,520	15.7 %	
セラミックス部門	5,544,701	7.5 %	68.8 %	5,156,301	11.1 %	69.0 %
耐摩耗セラミックス	2,678,136	6.2 %	33.2 %	2,522,710	17.1 %	33.7 %
耐熱セラミックス	1,946,600	10.6 %	24.2 %	1,760,531	7.2 %	23.6 %
機能性セラミックス	626,005	9.1 %	7.8 %	573,531	8.2 %	7.7 %
理化学用陶磁器・その他	293,959	-1.9 %	3.6 %	299,528	-4.4 %	4.0 %
インジニアリング部門	2,515,385	8.4 %	31.2 %	2,320,219	27.5 %	31.0 %
加熱装置	577,002	0.0 %	7.2 %	576,763	35.9 %	7.7 %
計測機器・その他	1,938,382	11.2 %	24.0 %	1,743,456	24.9 %	23.3 %
売上原価	5,712,564	7.6 %	70.9 %	5,309,052	15.5 %	71.0 %
販売費および一般管理費	1,095,082	-3.2 %	13.6 %	1,131,127	-1.6 %	15.1 %
営業利益	1,252,440	20.9 %	15.5 %	1,036,340	44.9 %	13.9 %
経常利益	1,258,015	19.3 %	15.6 %	1,054,520	45.3 %	14.1 %
当期純利益	697,198	13.9 %	8.7 %	611,851	69.2 %	8.2 %

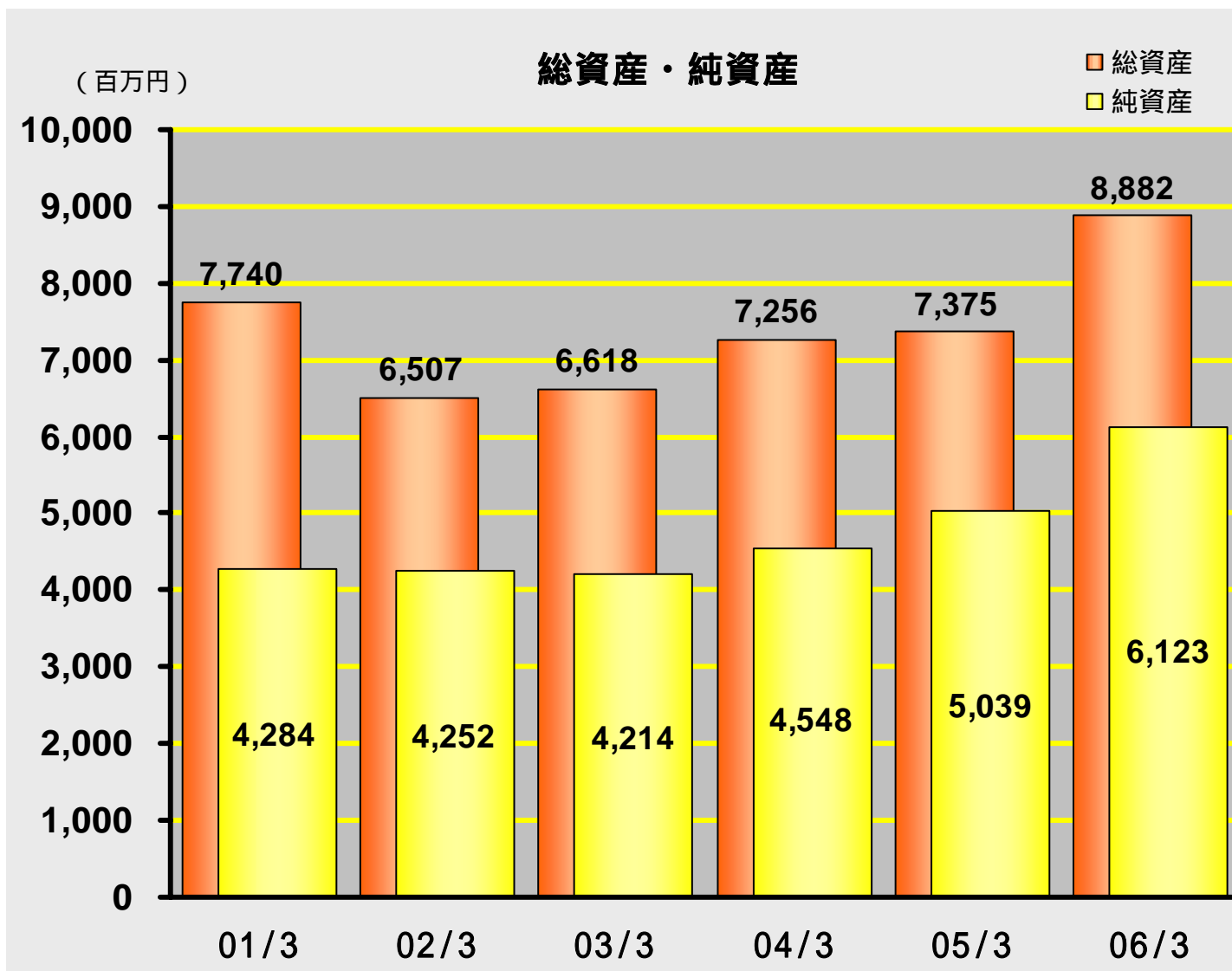
業績の推移



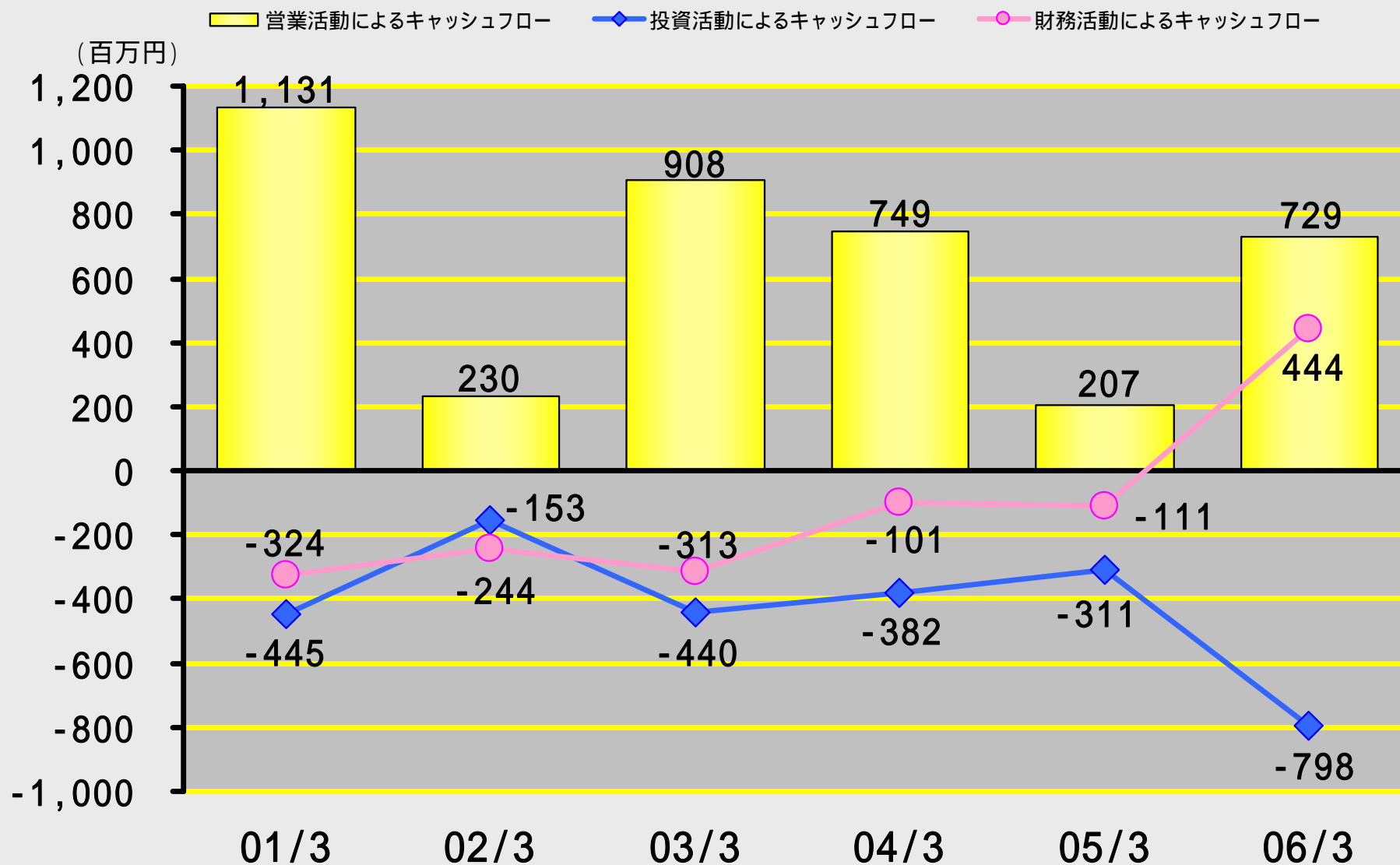




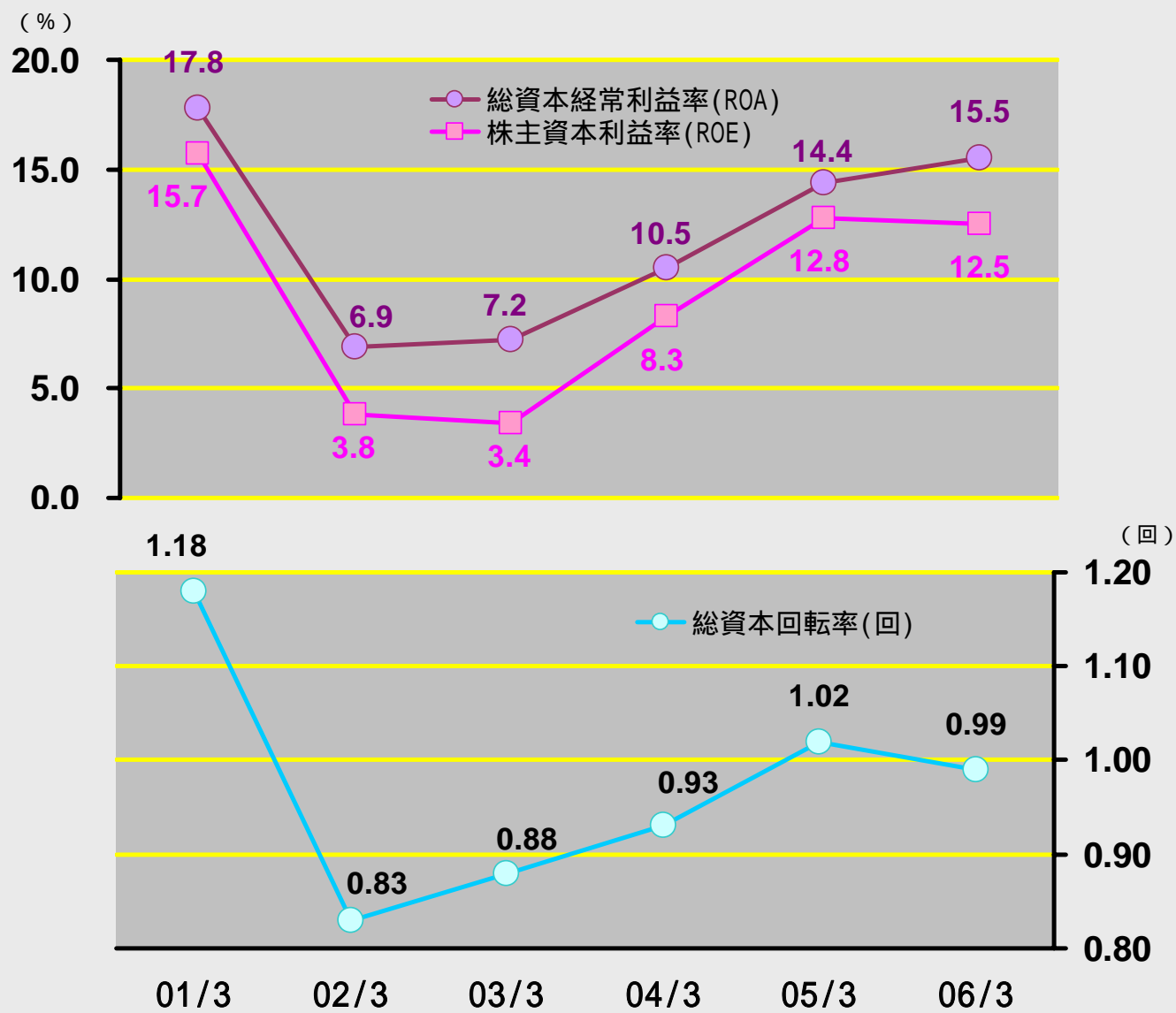
03/3月期から1株当たりの当期利益の計算については、当期利益から普通株主に帰属しない金額を控除して算出しています。



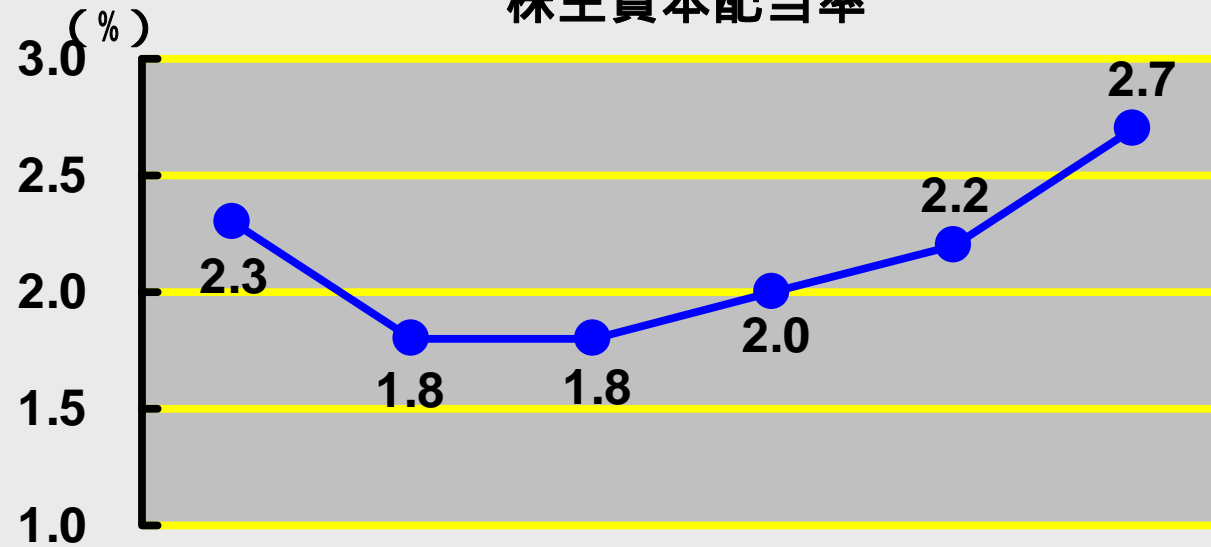
キャッシュフロー



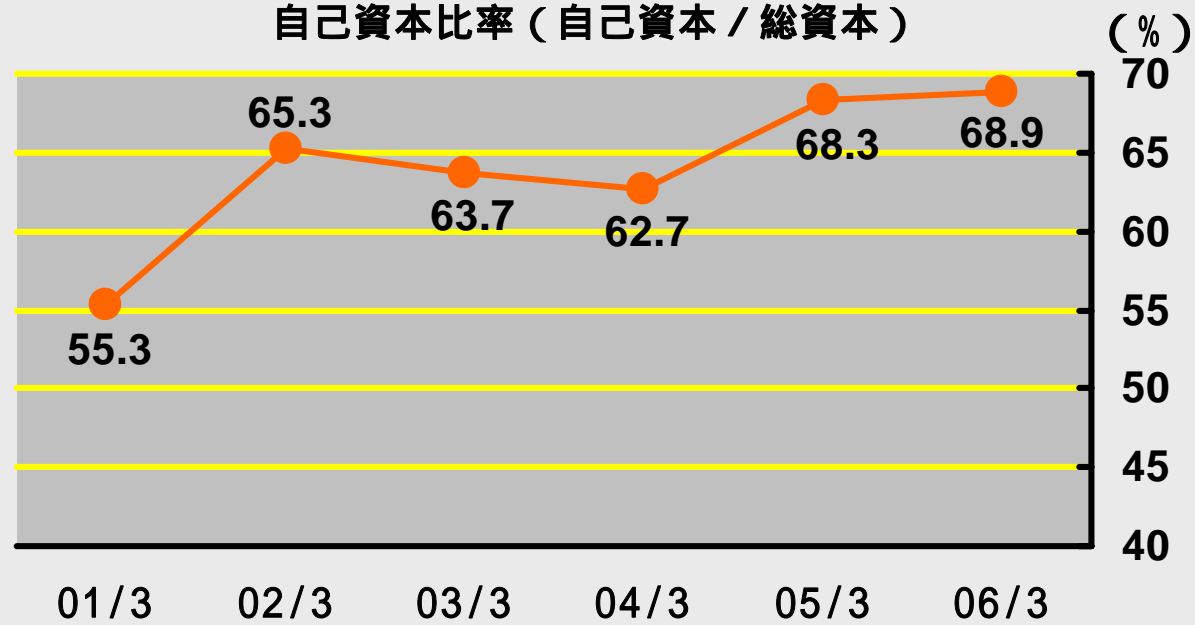
株主資本利益率、総資本経常利益率と総資本回転率(回)



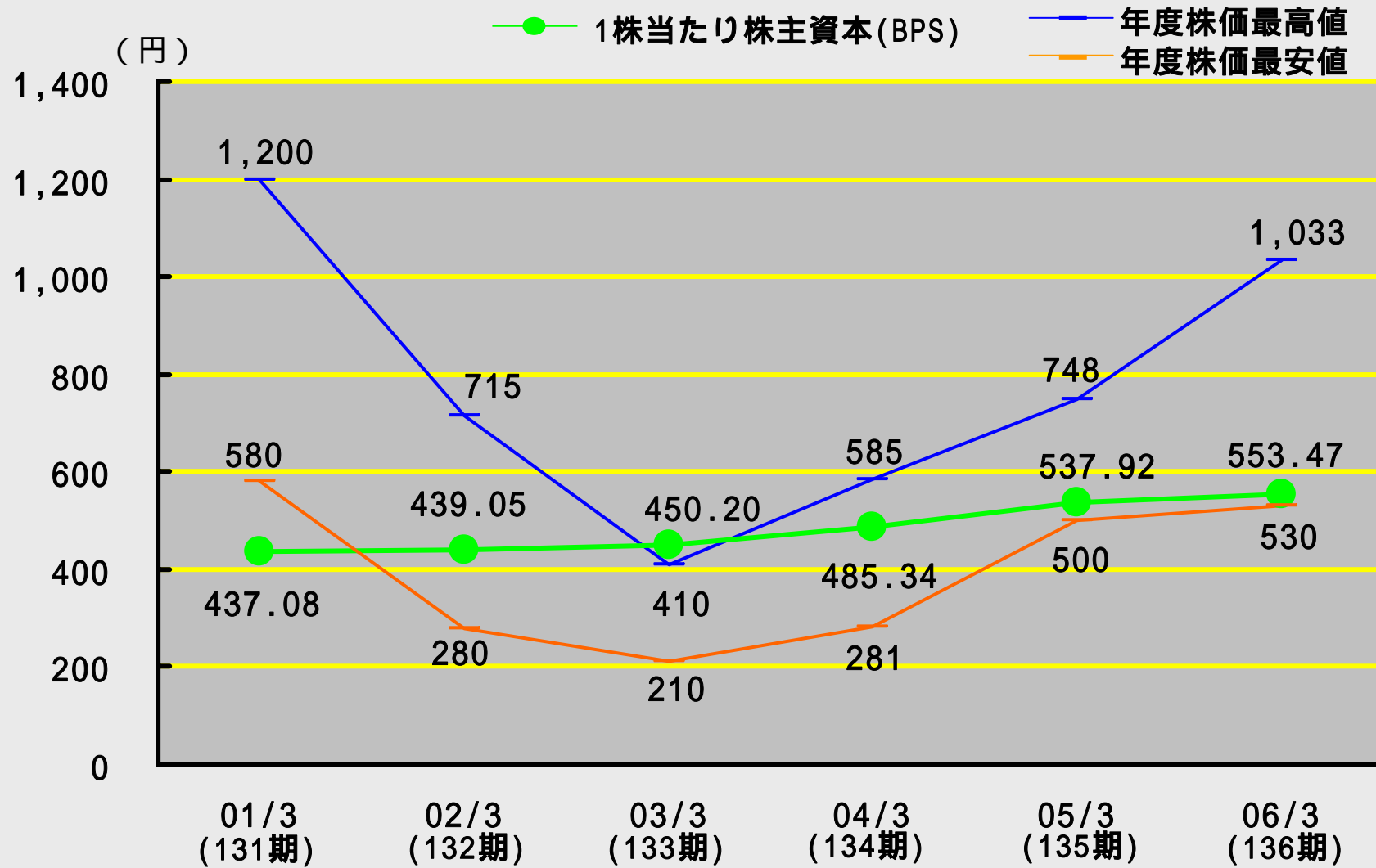
株主資本配当率



自己資本比率 (自己資本 / 総資本)

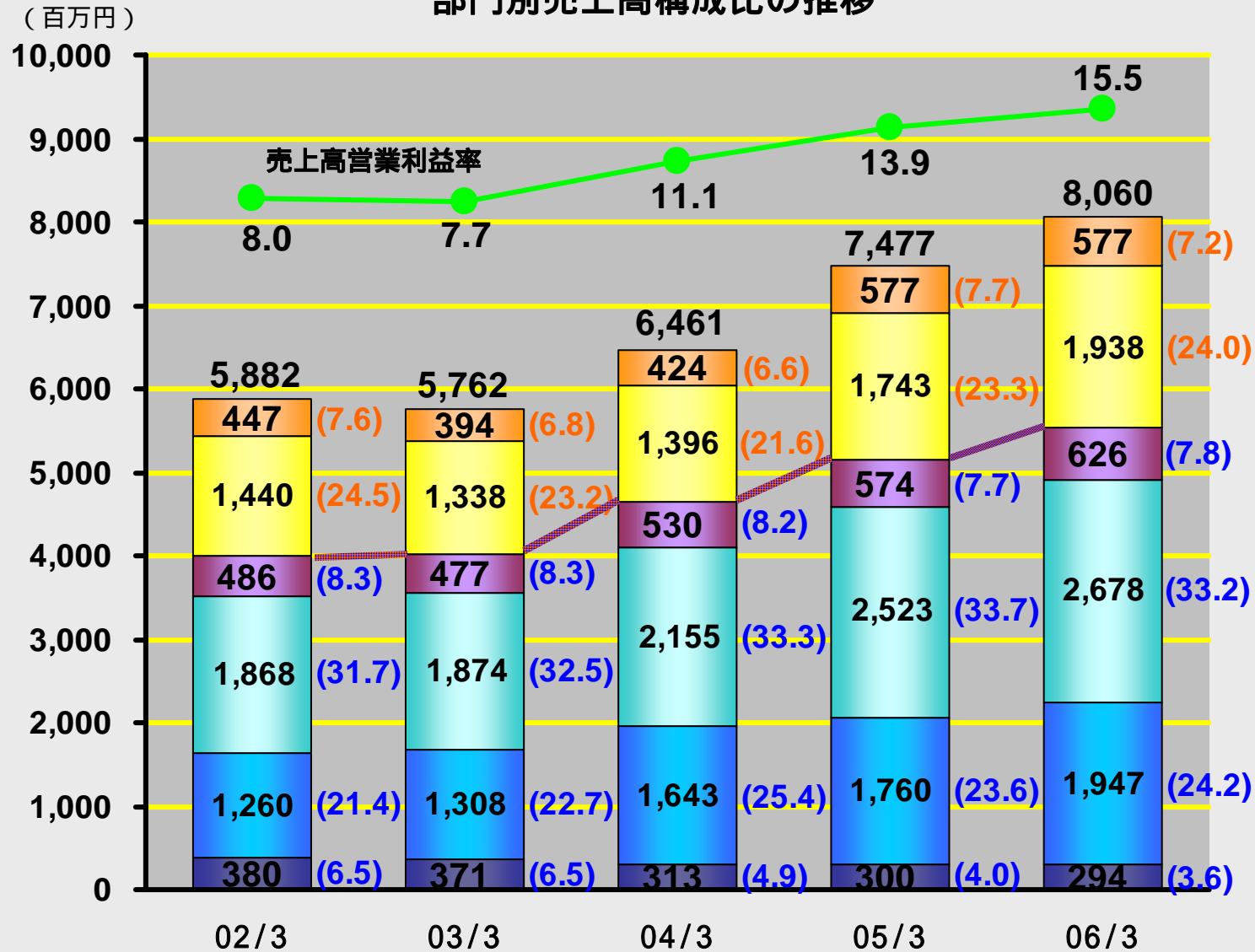


1株当たり株主資本と株価の推移



2005年5月20日付にて2005年3月末現在の株主に対し、1:1.1の株式分割を実施しています。

部門別売上高構成比の推移



エンジニアリング部門

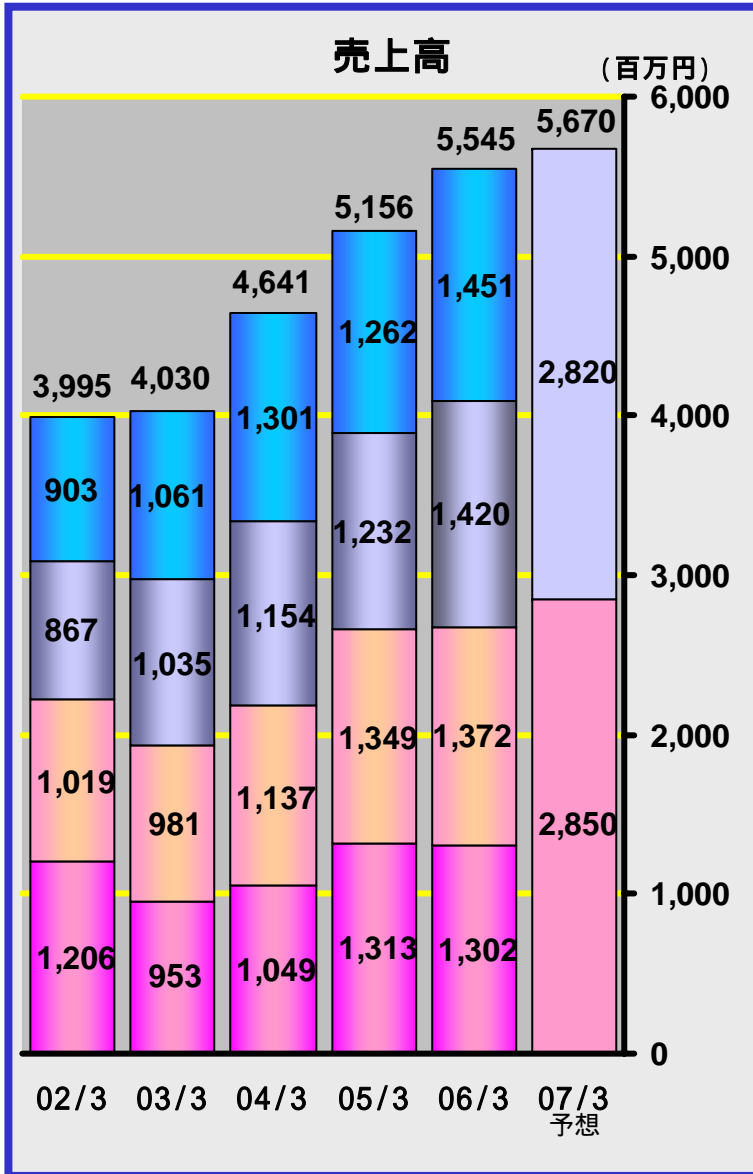
- 加熱装置
- 計測機器・同システム

セラミックス部門

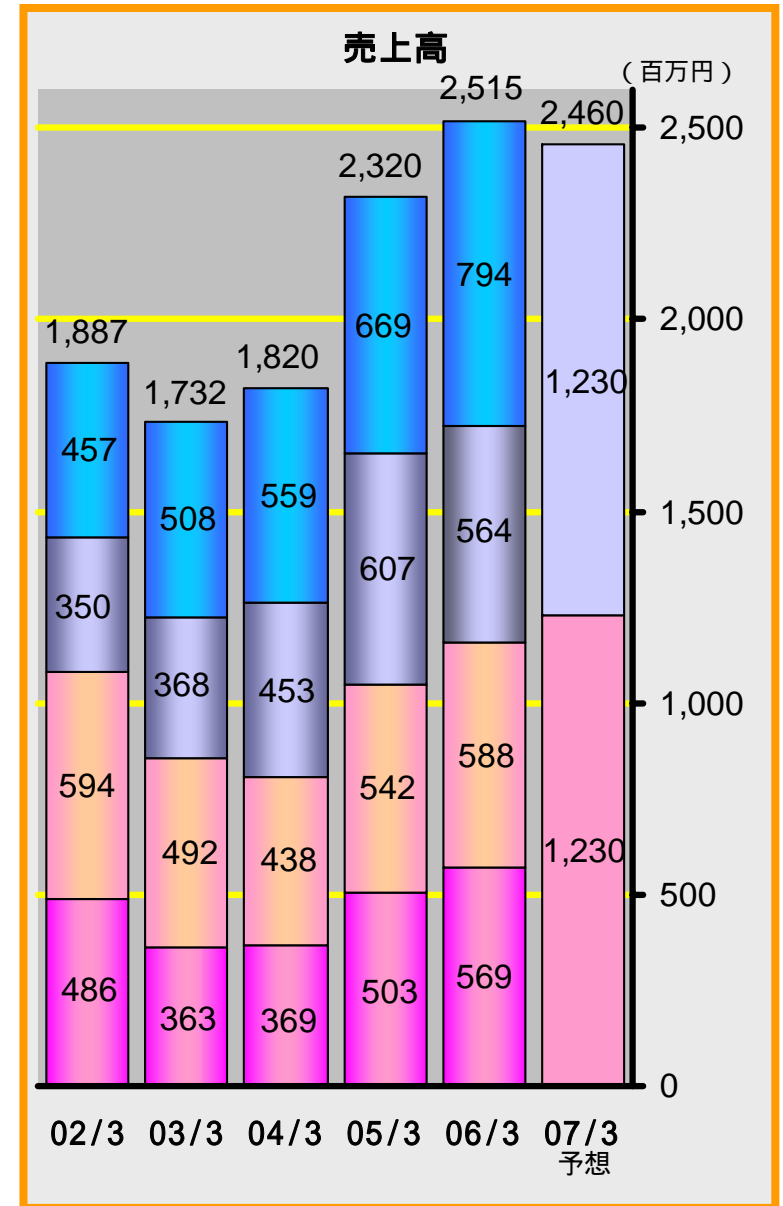
- 機能性セラミックス
- 耐摩耗セラミックス
- 耐熱セラミックス
- 理化学用陶磁器・耐火物・その他

売上高の推移

セラミックス部門



エンジニアリング部門



第4四半期

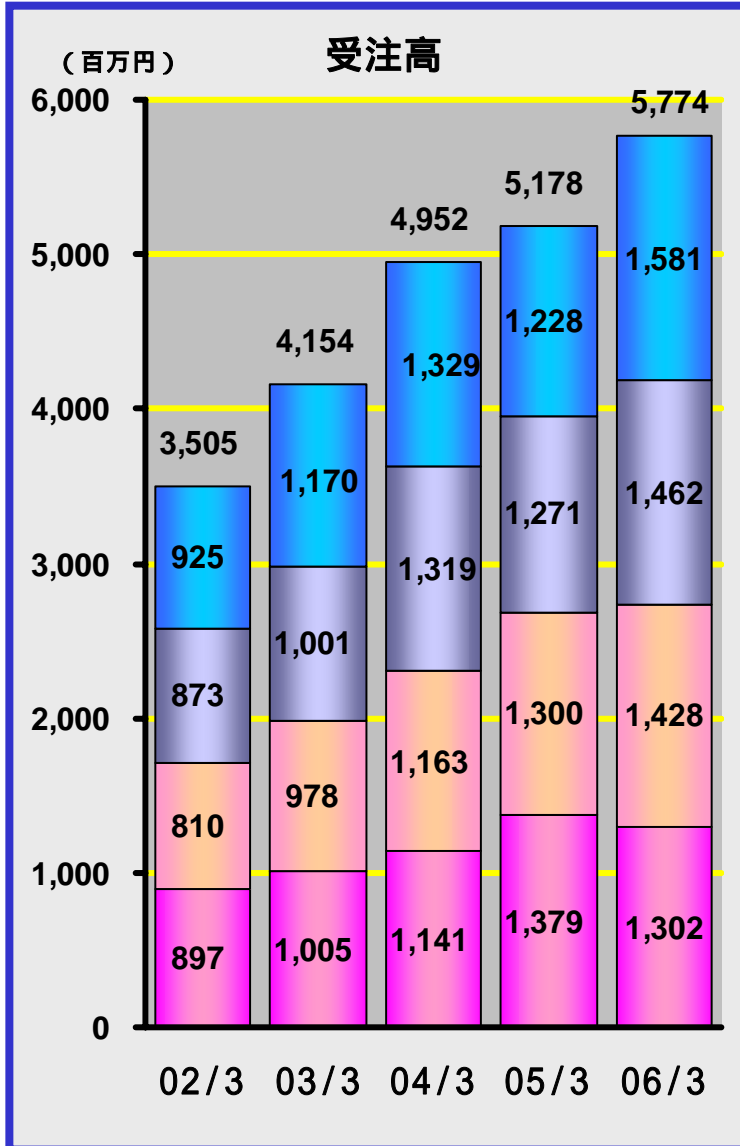
第3四半期

第2四半期

第1四半期

受注高の推移

セラミックス部門



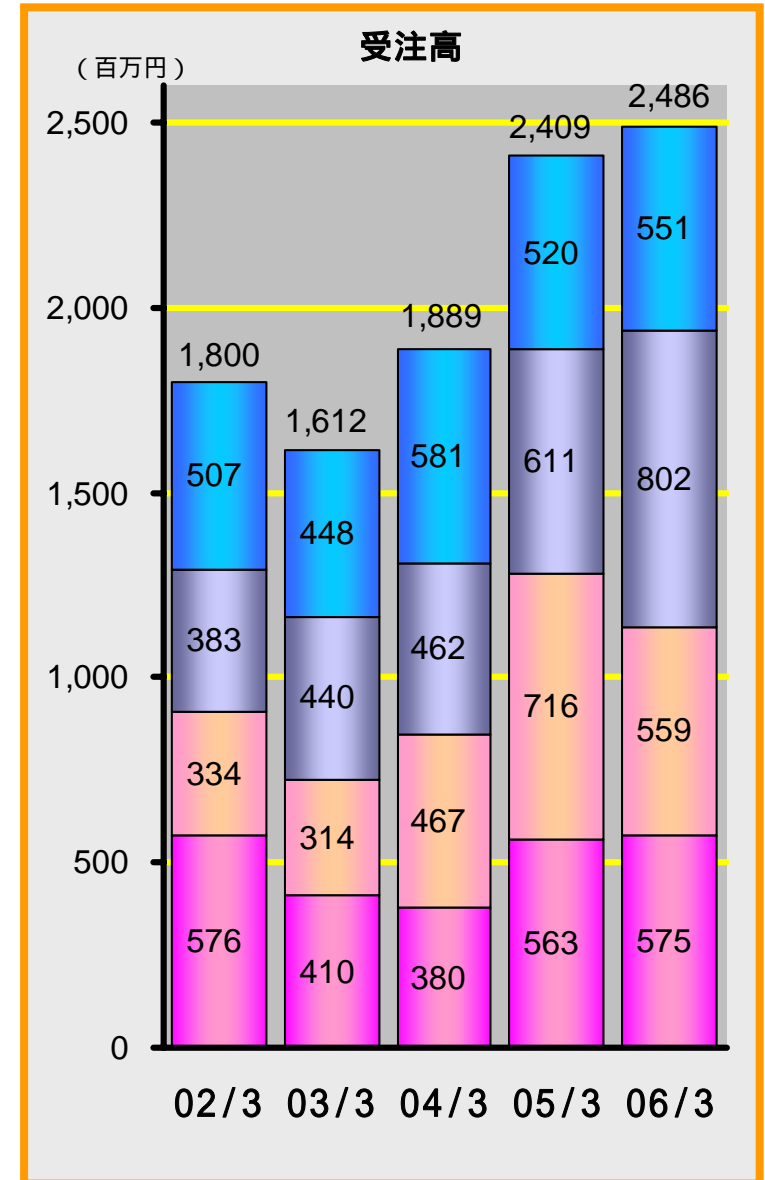
■ 第4四半期

■ 第3四半期

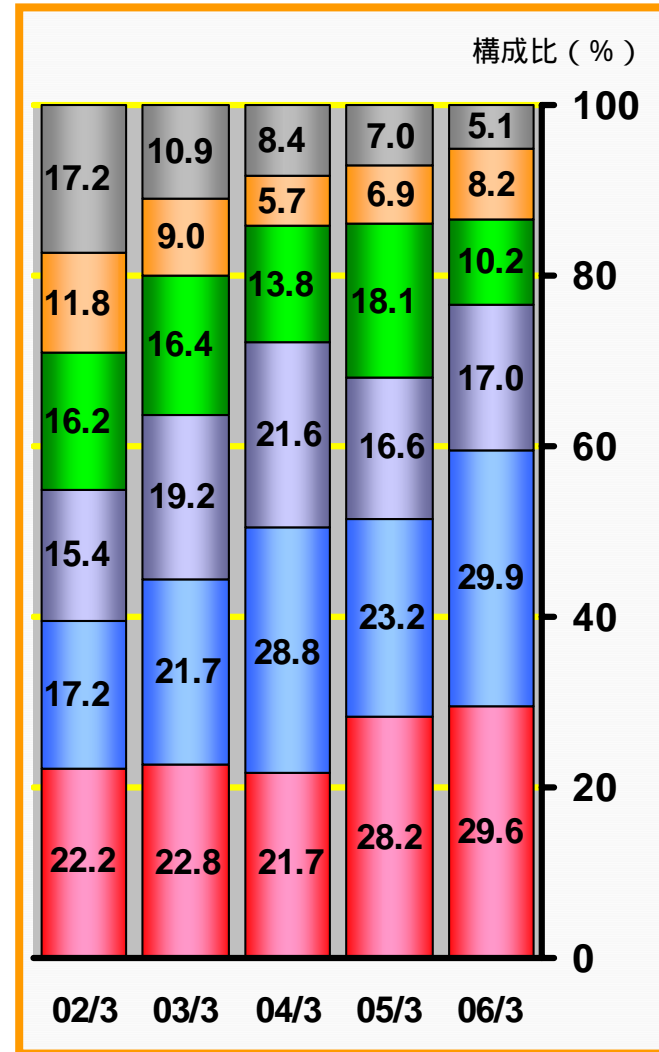
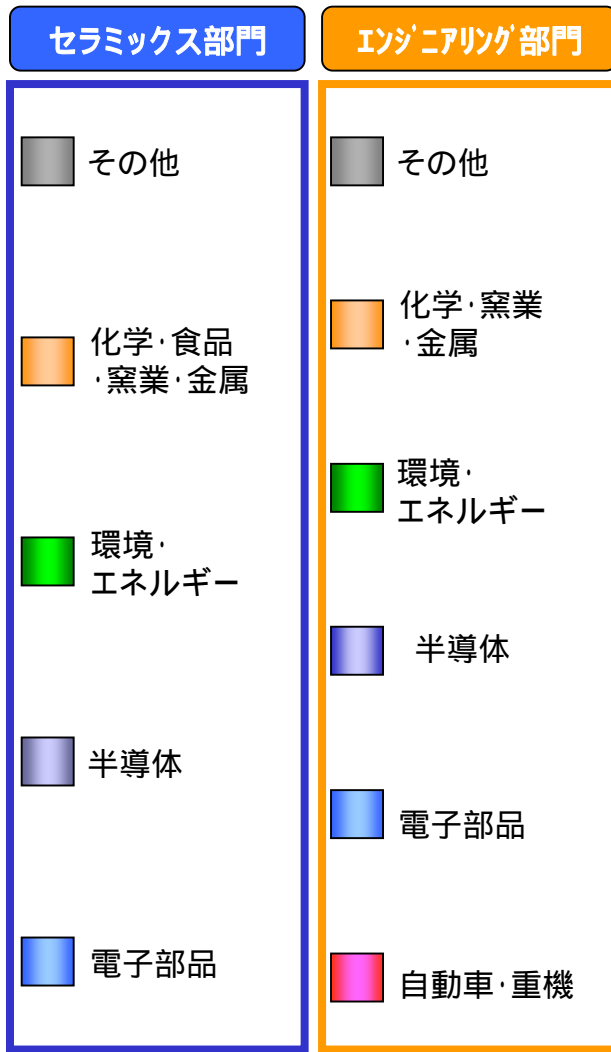
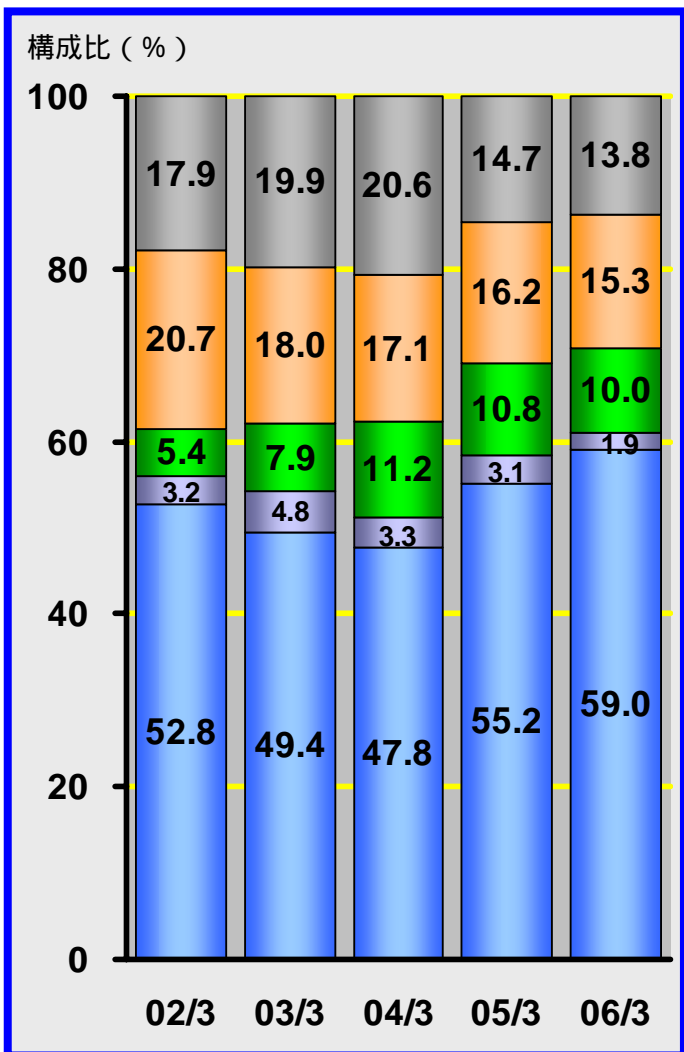
■ 第2四半期

■ 第1四半期

エンジニアリング部門



当社製品の市場別構成比の推移



セラミックス部門は蛍光体、二次電池用原料の熱処理に使用される容器等の電子部品向けが好調に推移しました。

エンジニアリング部門については客先企業の設備投資が活況だったことから電子部品向け、自動車・重機向け、半導体向け共に前年同期の実績を上回りました。

比較経営指標

	(単位)	06年3月期	05年3月期	04年3月期	03年3月期	02年3月期	01年3月期
売上原価率	(%)	70.9	71.0	71.1	73.2	73.2	70.5
売上高販売管理費率	(%)	13.6	15.1	17.8	19.1	18.8	14.5
売上高営業利益率	(%)	15.5	13.9	11.1	7.7	8.0	15.0
売上高経常利益率	(%)	15.6	14.1	11.2	8.1	8.4	15.1
自己資本比率	(%)	68.9	68.3	62.7	63.7	65.3	55.3
株主資本利益率(ROE)	(%)	12.5	12.8	8.3	3.4	3.8	15.7
総資本経常利益率(ROA)	(%)	15.5	14.4	10.5	7.2	6.9	17.8
総資本利益率	(%)	8.6	8.4	5.2	2.2	2.2	8.6
総資本回転率	(回)	0.99	1.02	0.93	0.88	0.83	1.18
1株利益	(円)	60.87	62.40	36.11	13.16	16.59	64.79
配当性向	(%)	24.6	19.2	27.7	60.8	48.2	15.4
株主資本配当率	(%)	2.7	2.2	2.0	1.8	1.8	2.3

YTZボール

コンデンサー用誘電体材料の粉碎に利用され成長を牽引

YTZボールとは？

- 名古屋工業研究所との共同研究で当社が開発した強くてしなやかなファイン・セラミックスである「ジルコニア」を用いて開発
- 耐摩耗性、耐久性が優れ、粉碎・分散効率が高く、電子部品材料、高機能材料の粉碎・分散に適している
- 水系による粉碎も行えるため、環境への負荷も少なく、また高寿命のためコストの削減、廃棄物の低減に寄与



極小YTZボール拡大写真

直径 0.05 ~ 25mm

コンデンサーへの利用で成長

- コンデンサーがより薄くなり、積層数が増大するにつれて、コンデンサー用の誘電体材料を極小に均一に粉碎する必要性が高まり、YTZボールが利用
- 粉碎するための部材も伸張

村田製作所、TDK、太陽誘電、京セラを始め、
ほぼ全てのコンデンサーメーカーで利用され、当社の成長を牽引

耐熱セラミックスの分野別用途

1. 焼成用容器・セッター

特徴

1. 耐熱性に優れ、高温での強度が高い
2. 化学薬品・熔融金属に対して安定で高温における耐食性が優れている
3. 高温での酸化・還元雰囲気の中でも極めて安定している

主な用途

1. リチウムイオン電池正極材料の熱処理
2. PDP材料の熱処理
3. 蛍光体材料の熱処理
4. NaS電池材料の熱処理



2. セラミックスチューブ

半導体拡散炉用を除き市場の80%以上の占有率をもつ。
 主な材質は、ムライト系6種類、アルミナ系2種類を生産。
 サイズ 直径: 1mm ~ 250mm 長さ: ~ 3500mm

主な用途

1) 加熱装置用搬送ローラ

a) 精密・高温用

- ・電子部品向け加熱装置(セラミックコンデンサ、
 圧電体、抵抗体、磁性体ほか)
- ・セラミック基板、パッケージ生産用
- ・液晶、PDP用ガラス基板の熱処理
- ・自動車用点火プラグの生産用
- ・蛍光体、顔料の合成用

b) 建材用 タイル、衛生陶器、瓦の生産用

c) 陶磁器用 食器、花瓶ほか



2) 炉心管 (大口径)

a) 単結晶育成用(光通信用部材、SAWフィルタ基板、 磁気ヘッドなど)

b) 半導体生産用拡散炉(大半は東芝セラなどSiC製であるが、 一部当社ムライト製)

c) 粉体合成炉(ロータリー熱処理炉、環状電気炉)

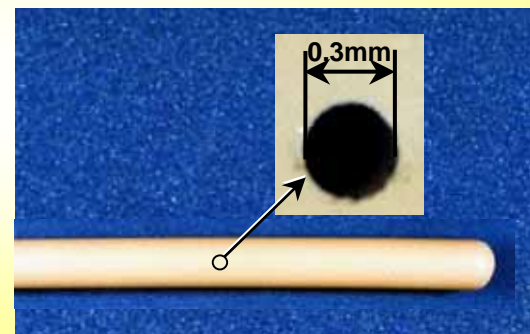
d) 環状雰囲気炉、廃棄物減容炉



3) 保護・ガス導入用

a) サポートチューブ、ラジアントチューブ

b) ガス吹込み管、ガス採取管 ほか



4) 温度測定用 温度センサの熱電対保護管、電気絶縁管

